



Exzellenz im Baugruppendesign sichtbar machen

Der **PCB Design Award** ist ein renommierter Berufswettbewerb für Baugruppendesigner im deutschsprachigen Raum. Verliehen wird er vom **Fachverband Elektronikdesign und -fertigung (FED)** im Rahmen der **FED-Jahreskonferenz am 23.-24. September 2026 in Bamberg**, und dies bereits zum **achten Mal**.

Der Award würdigt herausragende Designlösungen und macht die zentrale Rolle von Baugruppendesignern zwischen Entwicklung und Fertigung sichtbar. Ihre Arbeit prägt maßgeblich **Qualität, Kosten und Herstellbarkeit** elektronischer Produkte.

Warum teilnehmen?

- Hohe **berufliche Anerkennung**
- **Sieger- bzw. Nominierten-Urkunde** für alle Nominierten
- Präsentation der Gewinnerprojekte in der **Fachwelt**
- Eine Teilnahme ist **unabhängig von einer FED-Mitgliedschaft**

Welche Kategorien gibt es?

Der PCB Design Award wird in **vier Kategorien** verliehen:

1. **3D / Bauraum**
Komplexe mechanische Herausforderungen mit starren, starrflex oder flexiblen Leiterplatten.
2. **High-Power**
Lösungen für sehr hohe Spannungen, Ströme oder Verlustleistungen jenseits der üblichen Standards.
3. **High-Density**
Designs mit extrem hoher Integrationsdichte oder sehr hohen Übertragungsraten.
4. **Einfach genial**
Kreative, nachhaltige oder besonders wirtschaftliche Lösungen – genial einfach oder einfach genial.

Teilnahmebedingungen

- Offen für **alle Baugruppendesigner** im deutschsprachigen Raum
- Einreichung von **einem oder mehreren Designs** (je Design eine eigene Bewerbung)
- **Funktionsfähiger Prototyp** eines bestückten Schaltungsträgers erforderlich
- Jedes Design wird **bindend einer Kategorie** zugeordnet
- **Keine Design-Daten** – nur Beschreibung, Screenshots und Fotos
- Bewertung erfolgt **anonymisiert** durch eine **zur Vertraulichkeit verpflichtete Jury**
- Das Juryurteil ist **unanfechtbar**

Einzureichende Unterlagen (Auszug)

- Beschreibung der besonderen Design-Herausforderungen und Lösungen
- Verständliche Darstellung des Designs ohne Original-Design-Daten
- Fotos der vollständig bestückten Baugruppe (Ober- und Unterseite)

Einsendeschluss: 31. Mai 2026

Alle Infos unter: <https://www.pcb-design-award.de>

